

平行平板タイプ 真空プラズマ処理装置

PC-RIE Series



1. 多様なプロセス対応
アッシング、エッチング
クリーニング
表面改質(接着性向上 他)
低温焼結 等
2. 低コスト
低価格・低COO
3. 小フットプリント
W1200×D800(本体サイズ)
※電極サイズ`350mm角の場合
4. クリーンルーム対応

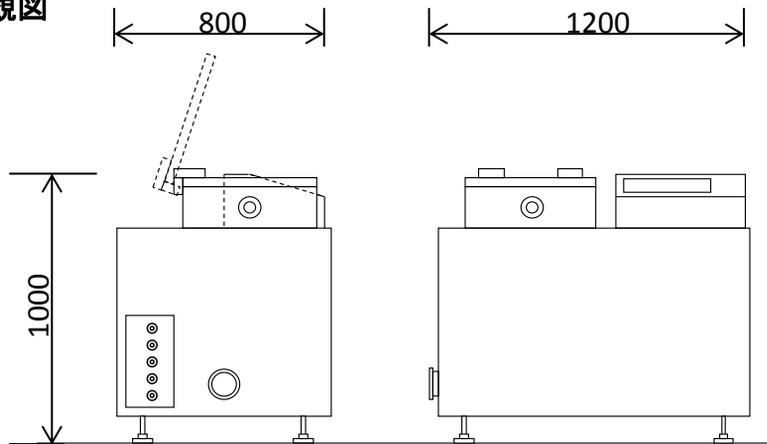


株式会社 電子技研

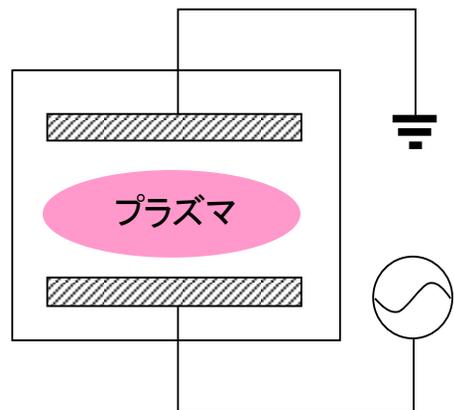
大阪府東大阪市川田4-6-4

TEL : 072-943-2006 FAX : 072-943-2007

外観図



放電イメージ



【主仕様】

標準仕様

1. 装置サイズ : 幅1200×奥行800×高さ1000
2. 電極サイズ : 350×350
3. 処理室温調 : 下部電極冷却水循環温調
4. 高周波発振器 : 13.56MHz / 1000W
5. 処理ガスライン : 1系統マスフロー制御

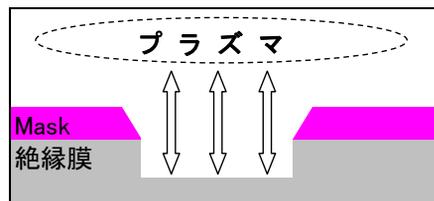
カスタマイズ仕様

- 電極サイズにより対応
電極サイズ(角/丸) 応相談
ガルデン循環温調
300W / 500W / 2000W
増設可能

※搬送機構、等が必要な場合は、ご相談下さい。
ご要望に応じた装置設計を致します。

【特長】

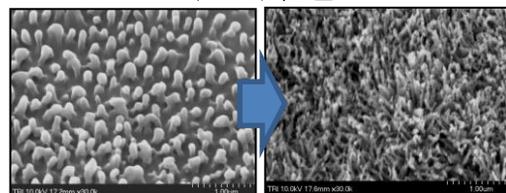
1. リアクティブイオンエッチング (RIE)
平行平板の下部電極へ高周波を印加することで
異方性プラズマ加工が可能
2. 容易なプロセス制御
各プロセスパラメーターが容易に調整可能



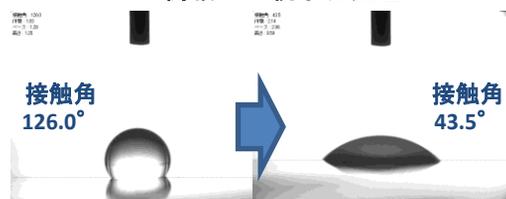
【応用事例】

1. レジスタアッシング / 絶縁膜エッチング
2. 各種メッキ前処理
3. 金属・樹脂・他への表面改質
(親水化 / 撥水化 / 接着性向上 / 還元)
4. プリント基板向け デスマリア処理
5. 半導体基板向け デスカム処理
6. 有機物除去
7. 低温焼結処理

デスマリア処理



PTFE樹脂への親水化処理



■ 東大阪本社に評価設備完備しております。随時 プロセス評価実験、受託処理をお請けしております。

弊社保有設備の電極サイズは、670×580です。

■ 技術紹介プレゼン、プラズマ応用相談を実施しております。

詳しくは、弊社 営業部までお気軽にお問い合わせ下さい。